



Dziewan

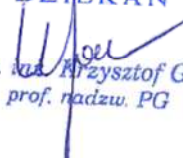
ZZ/753/009/U/2014

Gdańsk, 18.06.2014 r.

### OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

1. Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, na podstawie art. 3 ust. 2 oraz rozdziału 2 a ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, informuje o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie cięcia wytrawianych struktur krzemowych na waflach SOI i zaprasza do składania ofert.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cięcia wytrawionych struktur krzemowych na waflach SOI, zgodnie z opisem wyszczególnionym poniżej:
  - Cięcie płytek Si na SiO<sub>2</sub> (SOI) o rozmiarze 2'',
  - Rozmiary wycinanych elementów 5 x 5 mm,
  - Precyzja cięcia +/- 10 um,
3. Wymagania stawiane Wykonawc:
  - Cięcie z użyciem piły diamentowej w celu uniknięcia wtrąceń metalicznych,
  - Realizacja usługi w laboratorium o podwyższonej czystości ze względu na potencjalne zanieczyszczenie podłoża,
  - Wymagane doświadczenie w obróbce wafla Si oraz SOI,
4. Odpowiedzialność za zniszczenie powierzonego materiału leży po stronie oferenta.
5. Oferta powinna zawierać:
  - a) Przedmiot dostawy
  - b) Cenę oferty brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w PLN
  - c) Termin realizacji zamówienia
  - d) Warunki gwarancji
6. Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 26.06.2014 r., do godz. 13:00, na nr faksu (58) 347-24-45 lub mailem na adres: [logistyka@eti.pg.gda.pl](mailto:logistyka@eti.pg.gda.pl)
7. Kryteria oceny ofert  
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena – 100%  
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

DZIEWAN

  
dr hab. inż. Krzysztof Goczyła  
prof. nadzw. PG